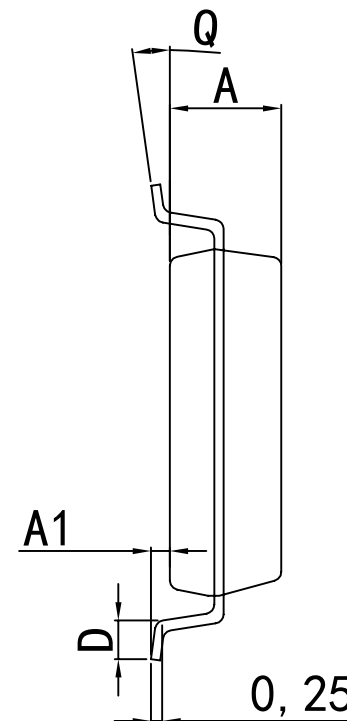
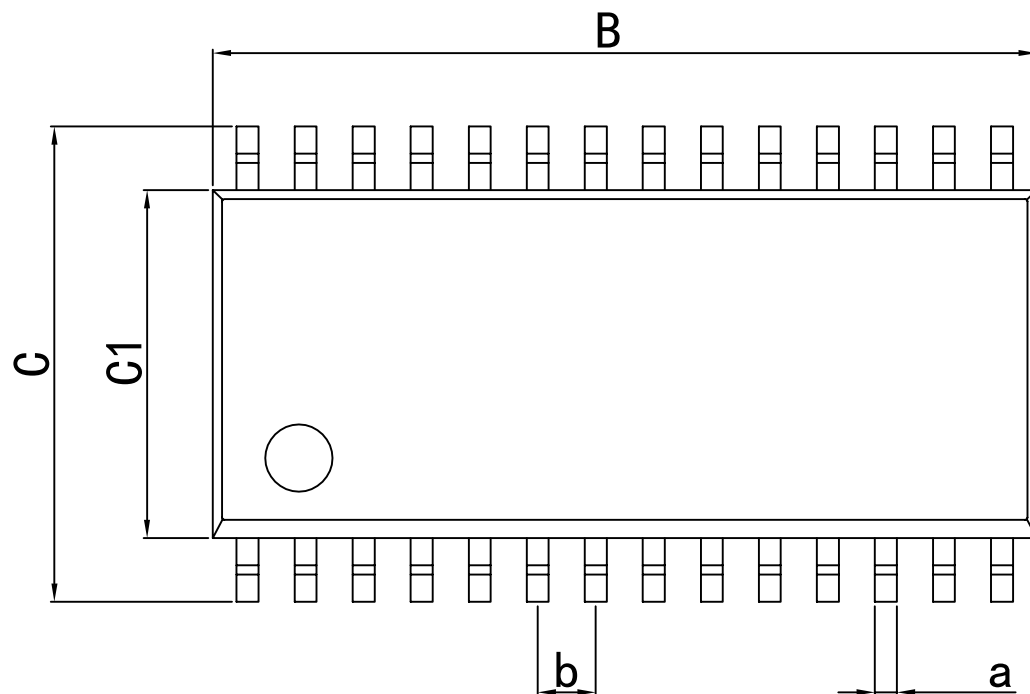




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

SOP-28

文件名称:
HG-SOP28

文件编号:
HGWXT-230054

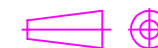
版本 VI.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-7-11

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT : mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b			
MIN	2.24	0.10	17.83	10.1	7.42	0.60	0°	0.35	1.27			
MAX	2.44	0.30	18.03	10.4	7.62	1.0	8°	0.48	BSC			